

115年度

半導體與重點科技產業人才發展基地

半導體與AI應用專業人才養成班

第 06期

招生簡章

主辦單位 | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

承辦單位 | 國立陽明交通大學、陽明交大雷射系統研究中心

訓練領域 | 工業類 | 電機工程

課程時數 | 231 小時

訓練期間 | 115年 12 月 14日(一)~116年 03 月 03 日(五)

上課時間 | 週一~週五 10:00~16:30或17:30

上課地點 | 依課程需求安排 遠距教學 或 實體授課

(遠距採線上授課，不提供實體教室；實體課必須到校上課。可參照末頁課表)

實體地點：新竹市大學路 1001 號 國立陽明交通大學

訓練費用 | 67,500 元。政府負擔費用：55,000 元，學員自行負擔：12,500 元。

符合自願/非自願失業者身分者，曾有投保紀錄，目前退保且待業中，訓練費用全免。

報名期間 | 即日起 至 115年 11 月 27 日(五) 10:00 止

甄試日期 | 115 年 12 月 02 日(三)

甄試地點 | 新竹市大學路 1001 號 國立陽明交通大學 科學三館(基礎科學大樓)

錄訓名額 | 40 人。

課程諮詢 | 國立陽明交通大學 林小姐 03-5712121#56098

可加入官方line (掃描右方QRcord 或搜尋@nycubase)

或Email 至lasercenter@nycu.edu.tw

課程報名 | 請上台灣就業通**登入會員後報名**

<https://its.taiwanjobs.gov.tw/Course/Detail?ID=165782>



主辦單位：勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 廣告

核准文號：115年07月13日 桃分署廣字第1150006189號

■ 課程簡介

隨著科技的進步，數位環境的飛快變化，大數據與AI人工智慧技術結合的各種應用，無論是金融、交通、醫療、購物...等各個生活層面，都全方位影響著我們生活。現今各個領域的大企業均投入對AI及大數據的大量研究及發展資源，並將所發展的技術，應用在不同的層面上，例如半導體、醫療、物聯網、金融、商業等領域的企業都競相網羅相關人才。為了培養具備卓越技術與創新能力的專業人才，陽明交大雷射系統研究中心特別設計了「半導體與AI應用專業人才養成班」，這個課程旨在提供學生所需的關鍵知識和實踐技能，課程包含半導體製程、設備、封裝、電子實驗、AI應用實作及Python與數據分析論等。

在當今高度數字化和智能化的世界中，科技產業對具備相關技能和知識的專業人才需求日益增加。以下是當前科技產業對「半導體與AI應用專業人才養成班」所涵蓋學科的需求概述：

1. 電子實驗：電子實驗是科技產業中不可或缺的領域，涉及設計和開發各種電子產品和系統的電路。
2. 半導體製程：半導體製程是製造微小電子元件的關鍵步驟，這些元件被廣泛應用於各種電子產品和系統。科技產業需要了解並掌握半導體製程的專業人才，以確保高效且可靠的製程運作。
3. 半導體封裝：半導體封裝是保護和連接微小電子元件的重要過程，它直接影響元件的可靠性和功能性。科技產業需要具有半導體封裝知識和技能的專業人才，能夠開發先進的封裝技術和解決相關問題。
4. 半導體設備介紹：學生將學習各種常見的半導體設備的原理、功能和操作方法。課程將介紹不同類型的半導體設備，例如沉積設備、蝕刻設備、光罩對位設備、曝光設備和清洗設備等，並深入探討其在製程中的作用和影響。
5. AOI光學檢測：AOI (自動光學檢測) 是科技產業中重要的品質控制方法，用於檢測電子產品和半導體元件製造過程中的缺陷和錯誤。科技產業需要具有AOI檢測知識和技能的專業人才，能夠有效監控產品品質並提高製造效率。
6. Python及數據分析：以Python讓學員進入到 AI人工智慧與機器學習的程式語言學習，結合不同的數據分析方式、可視化分析工具，逐步導入深度學習的CNN(卷積神經網路)、RNN(遞歸神經網路) 等應用，帶領學員進入跨領域的人工智慧數據分析專業領域。

「半導體與AI應用專業人才養成班」將提供專業且全面的學科課程，以滿足科技產業對於上述技能和知識的迫切需求。學生將透過理論授課、實踐操練和案例研究等學習方法，深入瞭解並掌握半導體製程、半導體封裝、電子實驗、AOI光學檢測以及人工智慧及數據分析等關鍵學科。這將使學生在科技與AI領域具備競爭力，為科技產業的發展做出重要貢獻。

■ 課程目標

透過「半導體與AI應用專業人才養成班」的學習，學員將能夠具備全面的半導體與AI應用知識和技能，滿足科技產業對於半導體製程、半導體封裝、電子實驗、AOI光學檢測和Python程式語言等領域人才的需求。同時，他們將具備解決問題和創新應用的能力，成為科技產業中的優秀人才。

1. 學習電子實驗：學員將學習電子實驗的基礎知識和設計原則，包括數位電路、類比電路和混合信號電路等，以培養設計和分析電路的能力，課程也包含實體電子實驗，實際讓學員操作並量測電子電路訊號。
2. 理解半導體製程：學員將學習半導體製程的基本原理和流程，包括材料處理、光罩製作、蝕刻、沉積和清洗等關鍵步驟，以培養對於製程控制和優化的能力。
3. 掌握半導體封裝技術：學員將深入瞭解半導體封裝的原理、方法和技術，包括封裝材料選擇、連結技術和熱管理等，以提高產品的可靠性和效能。
4. 半導體設備介紹：學生將學習半導體製造中常見的設備，掌握其原理、功能和操作方法。這包括沉積設備、蝕刻設備、光罩對位設備、曝光設備和清洗設備等。學生將學會操作這些設備，進行設備維護和故障排除，以確保製程的順利進行。
5. 瞭解AOI光學檢測技術：學員將學習自動光學檢測技術的原理和應用，包括影像處理、圖像辨識和缺陷檢測等，以提高產品的品質和效率。
6. 掌握Python程式語言：學員將學習Python程式語言的基礎和應用，包括語法、資料結構和函式庫的使用等，以培養開發科技應用和數據分析的能力。
7. 培養實踐技能：課程將著重實踐技能的培養，包括實驗室實習、案例分析和專案開發等，以提供學生實際應用所學知識的機會。
8. 強化問題解決能力：課程將培養學員的問題解決和創新思維能力，包括分析和解決科技產業中的技術和工程問題。

■ 課程特色及優勢

本中心設計強調半導體產業應用為目的，結訓後將學員連結至國內知名半導體大廠並提供企業媒合等服務。同時，我們將教學目標與特色銜接至經濟發展趨勢，透過高度整合的教學資源和師資，以效率化方式提升多元化半導體專業人才的培訓和養成。我們特別強調引導學生投入前瞻的固態電子元件領域，培養他們的嚴謹研究能力和創新思維。此外，我們也設計與半導體製程的相關的實作實驗課程，讓學生可以實際連結課堂所學知識，達到學用合一的目的；課程中也會邀請業界講師與學員講解實際職場應用，並在最後進行企業人才媒合。這些措施將有助於學生在半導體產業中取得成功，同時也提高了整個計畫的品質和可持續性。

■ 結訓後規劃與可從事行業

1. 科技製造業：具備半導體製程和封裝技術與AOI光學檢測等專業知識，可以在半導體製造、電子元件製造和設備製造等領域就業，負責製程控制、產品測試、品質管理等工作並參與新產品開發和創新專案。
2. 科技研發機構：具備科技與AI應用的綜合知識和技能，可以在科技研發機構中從事研究和開發工作，參與新技術的探索和實驗，推動科技創新。
3. 軟體開發公司：掌握Python程式語言和數據分析等相關知識，可以在軟體開發公司中從事軟體工具開發、數據分析和機器學習等相關工作，協助開發科技應用和解決複雜問題。

■ 參訓資格

1. 15歲以上對半導體產業、大數據分析與資料服務產業有興趣，具工作意願且工作技能不足之具中華民國國籍之失業者。
 2. 不符資格：
 - (1.) 在職勞工、自營作業者、公司或(行)商號負責人(含有限公司及股份有限公司之董監事)不得參訓。
 - (2.) 民眾有下列情事之一者，不得報名：
 - 已參加職前或在職訓練計畫之學員，訓練期間不得以失業者身分報名參加勞動部勞動力發展署各分署自辦、委託或補助辦理之職業訓練計畫。
 - 報名班次之開訓日尚於前次完訓或結訓班次之訓後 180 日內。
 - 曾參加職前訓練課程而被退訓，其退訓日尚於報名班次之開訓日前 1 年內。
 - 重覆參加相同班名之職前訓練課程，且其離、退訓日(不含適應期內離訓)、完訓或結訓日尚於報名班次之開訓日前 3 年內。
 - 報名班次之開訓日前二年內，已有二次以上離訓、退訓、完訓或結訓之職前訓練參訓紀錄(不含適應期內離訓)。
- 【備註】不得報名之參訓歷史統計範圍，以參加勞動部勞動力發展署及其所轄各分署自辦、委外或補助辦理之職前訓練課程或班次為限。
- (3.) 非自願離職者，需於報名截止日前至公立就業服務機構安排職訓諮詢，經適訓評估後持該機構開立之「職業訓練推介單」報名。
 - (4.) 依失業者職業訓練基準第4點第1項第2款之新住民、經入出國及移民法第十六條第三項或第四項規定許可其居留(泰國、緬甸地區單一中華民國國籍之無戶籍國民)、符合外國專業人才延攬及僱用法第二十五條第一項規定者，須檢具相關證明以參訓。

■ 報名方式

1. 成為台灣就業通會員：申請參加計畫前，應登錄為「台灣就業通」會員(電子郵件將作為後續訊息發布通知重要管道，請務必確實填寫)。
2. 線上報名：
 - (1.) 點選「職前訓練網」：<https://its.taiwanjobs.gov.tw/> (務必先登入再進行課程查詢)
 - (2.) 進行課程查詢：課程關鍵字「半導體」
(或是點選此連結報名課程：<https://its.taiwanjobs.gov.tw/Course/Detail?ID=165782>)
 - (3.) 點選課程頁面之「我要報名」，確認報名資訊及勾選相關欄位；
***報名當下須為失業者身分，投保狀態為退保。**
 - (4.) 報名完畢後，請於隔日(報名截止日前)至職前訓練網的會員專區，確認是否報名成功。
 - (5.) 最遲甄試 3 天前會依報名登錄之 Email 寄發通知信，若沒有收到，請先檢查垃圾信件匣，仍沒有則請盡快來電聯繫確認。
 - (6.) 請依通知信附件印出切結同意書(雙面列印)紙本簽名，文件請於甄試日當天繳交。
※ 專案報名 - 報名期間為在職者 (在保身分)者，甄試日前及參訓期間為失業者身分：因台灣就業通要求報名當下為退保狀態，若學員在報名期間尚未退保，可另外於以下表單填寫報名資料，人員將以專案報名形式為學員報名，完成後之流程同線上報名(4.)~(6.)。
<https://forms.gle/E1cLkbK2XyDvECDE8>
※ 曾研習過半導體之相關課程或線上學習(報名請註明曾修過之課程名稱)。
3. 請務必於報名截止前至就業通查詢報名是否成功，報名系統一旦關閉，無法修改與補報名。
4. 甄試通知：本課程將進行實體甄試，甄試說明於下節錄訓方式說明，甄試日前將以 e-mail 方式通知相關資訊，務必隨時留意。
5. 甄試結果將公告於招生網站 (<https://base.stem.lasercenter.nycu.edu.tw/>)，錄取學員請依開訓期間參與課程。
6. 課程洽詢：
email：lasercenter@nycu.edu.tw
窗口電話：林小姐 03-5712121 #56098
洽詢時間：每週一至週五上午 9:00-12:00 下午 1:30-5:00

■ 錄訓(甄試)方式

1. 甄試方式：筆試/口試
2. 甄試地點：新竹市大學路 1001 號 國立陽明交通大學 科學三館(基礎科學大樓)，筆試與口試於同一天進行，筆試結束後公布口試順序。
3. 筆試說明：
 - ✧ 筆試內容：邏輯測驗及基礎物理。
 - ✧ 筆試測驗開始 15 分鐘後不得進入試場應試，視為缺考；缺考或違反筆試考場規定情節重大者，不得參加口試。
4. 口試說明：
 - ✧ 依照簡歷表內容，以自我介紹方式進行口試，參訓紀錄、就業規劃、參訓動機。
 - ✧ 為維持雙方權益，口試進行中全程錄音。
5. 其他說明：詳細甄試說明、錄訓後通知與本課程相關資訊將以 e-mail 方式通知。
6. 錄訓說明：於甄試當日，以筆、口試方式進行，分數各占百分之五十。筆試及口試總成績達六十分以上始得錄訓為原則，並依筆試、口試成績計算總分及名次後，依序錄訓，如總分同分者，以筆試成績高者優先錄訓，未參加筆試或口試者，一律不予錄訓。
7. 備取生遞補：正取生放棄報到後，依備取順序遞補至開訓日起實際上課日 4 日。

■ 課程費用及補助說明

1. 課程費用 67,500 元。政府負擔 (80%) 費用：55,000 元，學員自行負擔 (20%)：12,500 元。
2. 參訓學員於開訓日(含)以前檢具特定失業者身分證明文件者 (具有就業保險法所定非自願離職者、就業服務法所定特定對象身分者及其他依行政規則所定得免費參訓者，詳細說明詳簡章第六頁)，得免繳自行負擔之個人訓練費用。
3. 學員自行負擔之訓練費，應於收到通知信後，**開訓前**繳交予訓練單位，並向訓練單位索取收據正本；已報名繳費但因故無法參訓者，**得於開訓前申請退還所繳費用**，未於開訓前申請者，**已繳交之訓練費用，除該班次停辦外，一律不予退還。(請務必於通知後再匯款！)**

■ 課堂用書

學員在**正式錄訓**後，將依照課程規畫提供課堂參考書，以下為書籍明細：

	書名	搭配課程
1	半導體製程技術導論	半導體製程技術
2	Python最強入門	Python與AI數據分析
3	Verilog硬體描述語言數位電路：設計實務	電子實驗

※課堂用書由辦訓單位提供，贈書細節將於錄訓後通知，實際用書以錄訓通知為主。

■ 課程注意事項

1. 為確保您的上課權益，報名後若未收到任何回覆，請來電洽詢方完成報名。
2. 如需取消報名，請於開課前 3 日以 email 通知承辦單位聯絡人並電話確認。
3. 為尊重講師之智慧財產權益，恕無法提供課程講義電子檔。
4. 為配合講師時間或臨時突發事件，承辦單位有調整日期或更換講師之權利。
5. 學員請務必留意出缺勤時數，如需請假，請務必填寫請假單。如遇離（退）訓，須依規定填寫離訓申請單。

※學員於參訓期間有下列情事之一，訓練單位應報請機關(分署)同意後，辦理退訓：

- 1.) 曠課時數達全期訓練總時數 4%者。
 - 2.) 未到課時數達全期訓練總時數 10%者。
 - 3.) 參訓期間行為不檢情節重大者。
 - 4.) 參訓期間未達總訓練時數 1/2 且找到工作而未能繼續參訓者。
 - 5.) 參訓期間無前項離訓事由而未能繼續參訓者。
6. 結訓證書：學員受訓期間成績合格者，可獲得結訓證書。
- ※學員中途離訓、經訓練單位勒令退訓或考核成績未達標準者，將不發給結訓證書
7. 企業說明會或媒合相關活動將依照與企業排定之日期為主，將於課程期間通知學員。
 8. 課程授課形式含遠距線上授課及實體到校上課。遠距採線上授課，不提供實體教室；實體課必須到陽明交大 新竹光復校區上課。

詳細課表可參考本文文末附件，請務必留意。

※課程若遇天災或其他不可抗力因素調整或調動，將會另行通知學員

■ 權益說明：學費補助身分

職前訓練免負擔費用學員身分別及參訓權益說明如下：

失業者身分		資格條件及應檢附證明文件
1	就業保險被保險人非自願離職失業者	一、資格條件：檢附最後離職投保單位所出具非自願離職事由之證明文件，並經公立就業服務機構推介安排職業訓練。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本或有效期間之居留證影本。 (二)公立就業服務機構開立之職業訓練推介單。
2	獨力負擔家計之失業者	一、資格條件： (一)失業者具下列情形之一，且獨自扶養在學或無工作能力之直系血親、配偶之直系血親或前配偶之直系血親者： 1. 配偶死亡。 2. 配偶失蹤，經向警察機關報案協尋，達6個月以上未尋獲。 3. 離婚。 4. 受家庭暴力，已提起離婚之訴。 5. 配偶入獄服刑、因案羈押或依法拘禁。 6. 配偶應徵集、召集入營服義務役或替代役。 7. 配偶身心障礙或罹患重大傷、病致不能工作。 8. 其他經公立就業服務機構認定或經直轄市、縣(市)政府社政單位轉介之情況特殊需提供協助。 (二)因未婚且家庭內無與申請人有同居關係之成員，而獨自扶養在學或無工作能力之直系血親卑親屬者。 (三)因原負有法定扶養義務者死亡、失蹤、婚姻、經濟、疾病或法律因素，致無法履行該義務，而獨自扶養在學或無工作能力之血親者。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)註記現住人口及詳細記事之全戶戶口名簿影本。 (三)全戶內年滿15歲至65歲受撫養親屬之在學或無工作能力證明文件影本： 1. 在學證明指25歲以下仍在國內公立或已立案之私立學校就讀在學證明文件(但不包含就讀空中專科及大學、高級中等以上進修學校、在職班、學分班、僅於夜間或假日上課或遠距教學)。 2. 無工作能力證明文件指罹患重大傷、病，經醫療機構診斷必須治療或療養3個月以上之診斷證明文件。 (四)其他足資證明身分之文件。
3	中高齡之失業者	一、資格條件：年滿45歲至65歲間之失業者。 二、應備文件：國民身分證正反面影本。

4	身心障礙之失業者	一、資格條件：領有身心障礙手冊或證明之失業者。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)有效期限內之身心障礙手冊或證明文件影本。
5	原住民之失業者	一、資格條件：戶籍登記為原住民之失業者。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)註記原住民身分之戶口名簿影本。
6	低收入戶或中低收入戶中有工作能力之失業者	一、資格條件：指社會救助法中所規定之低收入戶或中低收入戶內，有工作能力而自願就業之失業者。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)低收入戶或中低收入戶身分證明文件影本。
7	長期失業者	一、資格條件：指連續失業期間達1年以上，且辦理勞工保險退保當日前3年內，保險年資合計滿6個月以上，並於最近1個月內有向公立就業服務機構辦理求職登記者。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)開訓前1個月內向公立就業服務機構辦理求職登記證明文件。
8	二度就業婦女之失業者	一、資格條件： (一)因家庭因素退出勞動市場2年，重返職場之婦女。 (二)退出勞動市場期間： 1.自該婦女最近1次勞工保險效力停止之翌日起算。 2.未有勞工保險投保紀錄者，自其最後任職事業單位出具服務證明所載離職日之翌日起算。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)因家庭因素退出職場佐證文件影本(如以親屬重大傷病卡或身心障礙證明佐證因家庭照顧因素、以戶口名簿證明結婚、生育或親屬年邁等、或以切結書切結說明；親屬範圍參照勞工請假規則第3條勞工喪假喪亡對象)。 (三)無勞保紀錄者，需再檢附最後任職事業單位出具之服務證明(載明離職日)。 (四)其他足資釋明身分之資料。
9	家庭暴力被害人失業者	一、資格條件：家庭暴力被害人。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)下列證明文件之一： 1.直轄市、縣(市)政府開立之家庭暴力被害人身分證明文件。 2.保護令(通常保護令、暫時保護令、緊急保護令)影本。 3.判決書影本。

10	更生受保護人之失業者	一、資格條件：更生受保護人。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)出監證明或其他更生受保護人身分證明書影本。
11	15歲以上未滿18歲有就業需求之未就學未就業少年	一、資格條件：年滿15歲以上未滿18歲之未就業未就學少年。未就學係指完成國民義務教育階段，且無學籍或休學狀態。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。(二)切結書。 (三)如為休學中，應再檢附休學證明文件。
12	新住民之失業者	一、資格條件：符合促進新住民就業補助作業要點第2點第1項第3款規定之新住民失業者。 二、應備文件：有效期間之居留證明文件。
13	性侵害被害人失業者	一、資格條件：性侵害被害人。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)下列證明文件之一： 1.直轄市、縣(市)政府開立之性侵害被害人身分證明文件。 2.曾遭受性侵害之證明(警察機關處理性侵害事件調查表或報案單、就醫、診療、驗傷之證明)。 3.判決書影本。
14	跨國(境)人口販運被害人失業者	一、資格條件：經檢察官鑑別為跨國(境)人口販運被害人失業者。 二、應備文件： (一)參訓期間有效之臨時停留許可證影本。 (二)勞動部核發之工作許可影本。
15	無戶籍國民之失業者	一、資格條件：符合入出國及移民法第16條第3項規定取得居留之泰國、緬甸地區單一中華民國國籍之無戶籍國民之失業者。 二、應備文件：(一)臺灣地區居留證影本。(二)工作許可公文
16	無國籍人民之失業者	一、資格條件：符合入出國及移民法第16條第3項、第4項規定取得居留身分之泰國、緬甸、印度或尼泊爾地區無國籍人民，且已依就業服務法第51條第1項第1款規定取得工作許可之失業者。 二、應備文件： (一)外僑居留證影本。 (二)勞動部核發之工作許可函影本。
17	因犯罪被害之失業者	一、資格條件：符合下列資格，並於犯罪事實發生後6年內報名參訓者： (一)因犯罪行為被害而死亡者之配偶或直系親屬。 (二)因犯罪行為被害受重傷者之本人、配偶或直系親屬。 (三)因犯罪行為被害死亡者或受重傷者之未成年子女之監護人。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。

		(二)財團法人犯罪被害人保護協會開立之因犯罪被害之身分證明書正本。
18	因重大災害受災之失業者	一、資格條件：依勞動部因應重大災害職業訓練協助計畫認定之因重大災害受災之失業者。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)下列受災證明影本之一： 1.鄉(鎮、市、區)公所開立之房屋受損證明。 2.農政機關或單位開立之農作物受損證明。 3.家屬因重大災害死亡或重傷之證明。 4.相關政府機關開立之重大災害受災證明文件。
19	受貿易自由化影響失業者	一、資格條件：符合充電起飛計畫第6點第1項第2款規定之受貿易自由化影響失業者。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)屬適用本對象資格條件之勞工相關證明文件(可由系統勾稽者免繳)。
20	自立少年之失業者	一、資格條件：符合衛生福利部社會及家庭署訂定之提升少年自立生活適應協助服務量能計畫之自立少年資格，且於身分證明文件有效期限內報名參訓之失業者： (一)以年滿15歲以上未滿18歲經2處以上安置，仍無法適應機構生活，經主管機關評估有需要且具自立生活能力者優先，且應至少服務至其年滿18歲。 (二)年滿18歲結束安置1年內者。 (三)結束安置逾1年，經主管機關評估仍有必要提供自立生活適應協助者。 (四)其他經受委託之安置教養機構或民間團體評估有需要自立生活，報經地方主管機關核定同意提供其自立生活適應協助者。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)地方主管機關開立之自立少年身分證明文件。

21	其他經直轄市、縣(市)政府或其委託計畫之社工人員訪視評估確有經濟困難，且有就業意願之失業者	一、資格條件：經直轄市、縣(市)政府或其委託計畫之社工人員訪視評估確有經濟困難，且有就業意願。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)公立就業服務機構開立之職業訓練推介單。
22	高齡之失業者	一、資格條件：逾65歲以上之失業者。 二、應備文件：國民身分證正反面影本。
23	就業保險被保險人自願離職失業者	一、資格條件：曾取得就業保險法被保險人身分之自願離職失業者。 二、應備文件：國民身分證正反面影本或有效期間之居留證影本。
24	因職業傷害或罹患職業疾病，經醫師診斷喪失部分工作能力之失業者	一、資格條件：因職業傷害或罹患職業疾病，經醫師診斷喪失部分工作能力，其失能程度符合勞工保險失能給付標準第二等級至第十五等級規定之項目。 二、應備文件：職業災害失能之相關證明文件如勞保局失能給付核定公文、勞保局或職安署之失能補助核定公文。 三、屬移工，須為未經雇主依就業服務法第五十六條第一項規定通知連續曠職三日失去聯繫者，並應再檢附有效期間之居留證明文件。
25	其他經中央勞政主管機關認為有必要者。	資格條件及應備文件依規定辦理。

※ 具備前述各項身分之失業者，如加保於職業工會、農會或漁會，得以「報名參訓資格審查切結書」切結確實無工作，而以原失業者身分免費參訓。

※ 非屬前述各項身分、且參加職業工會、農會或漁會勞工保險之被保險人，比照一般國民參加失業者職業訓練，須自行負擔 20%之訓練費用。

※ 依勞動部促進新住民就業補助作業要點之用詞定義，新住民 指下列人員：

1. 與在中華民國境內設有戶籍之國民結婚，且獲准在臺灣地區居留之外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民。
2. 前目之外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民，與其配偶離婚或其配偶死亡，而依法規定得在臺灣地區繼續居留工作者。
3. 符合前二目規定，且已依法獲准在臺灣地區定居或經歸化取得我國國籍者。

■ **權益說明：生活津貼及學習獎勵金** **若有異動，以台灣就業通公告為主。**

職前訓練課程依照學員的資格分為生活津貼及學習獎勵金，下表簡述大綱，細節將於表後描述：

類型	適用對象	給付金額 (皆給付至多 2 個月)	撥款單位
生活津貼	被保險人非自願性離職	每月按申請人離職辦理本保險退保之當月起前 6 個月平均投保薪資百分之六十發給「職業訓練生活津貼」，最長發給 6 個月。	勞工保險局
	就業服務法第 24 條第 1 項各款所列失業者	申請人於訓練期間每人每月按基本工資百分之六十發給職訓生活津貼 (申請金額將會依基本工資有所調整，2026 年基本工資為 29,500 元，基本工資之 60% 為 17,700 元)，最長發給 6 個月。	訓練單位
學習獎勵金	15-29 歲本國籍失業青年	每月 8,000 元 * 如已參加產業新尖兵並已領取過，則不得再領取	桃竹苗分署

一、職業訓練生活津貼

(一)全日制職業訓練，應符合下列條件：

訓練期間 1 個月以上；每星期訓練 4 日以上；每日訓練日間 4 小時以上；每月總訓練時數 100 小時以上。

(二)參訓期間得申請職業訓練生活津貼身分別

1. 非自願離職失業者

需於報名截止日前先至公立就業服務機構安排職訓諮詢，經適訓評估後持該機構開立之「職業訓練推介單」及「就業保險職業訓練生活津貼給付申請書及給付收據」報名參加全日制職業訓練，經甄試錄訓後，其職業訓練生活津貼由勞工保險局發放。

非自願離職失業者如同時具有下列第 2-11 項所列身分者，應優先以非自願離職身分申請就業保險法職業訓練生活津貼。若未優先申請就業保險法職業訓練生活津貼，將不予核撥就業促進津貼實施辦法職業訓練生活津貼，系統會持續勾稽至結訓後 2 年，若發現有違反規定之情形，將撤銷及追繳已領取之津貼。

2. **獨力負擔家計者：**本人及受扶養親屬戶口名簿影本(受撫養親屬年滿 15 歲至 65 歲者，需再檢具「在學證明書」或「無工作能力證明」文件影本)。

甲、具下列情形之一，且獨自撫養在學或無工作能力之直系血親、配偶之直系血親或前配偶之直系血親者。

A、配偶死亡。

B、配偶失蹤，經向警察機關報案協尋，達 6 個月以上未尋獲。

C、離婚。

D、受家庭暴力，已提起離婚之訴。

E、配偶入獄服刑、因案羈押或依法拘禁。

F、配偶應徵集、召集入營服義務役或替代役。

G、配偶身心障礙或罹患重大傷、病致不能工作。

H、其他經公立就業服務機構認定或經直轄市、縣(市)政府社政單位轉介之情況特殊需提供協助。

乙、因未婚且家庭內無與申請人有同居關係之成員，而獨自扶養在學或無工作能力之直系血親卑親屬者。

丙、因原負有法定扶養義務者死亡、失蹤、婚姻、經濟、疾病或法律因素，致無法履行該義務，而獨自扶養在學或無工作能力之血親者。

3. **中高齡者**：指年滿 45 歲至 65 歲之間者。(以開訓日為計算標準)。

4. **身心障礙者**：指領有身心障礙手冊者 (未過期之有效資料)。

5. **原住民**：戶口名簿已登記原住民者。

6. **低收入戶或中低收入戶中有工作能力者**：指鄉鎮區公所開立的低收入戶或中低收入戶中之證明。

7. **長期失業者**：指連續失業期間達 1 年以上，且辦理勞工保險退保當日前 3 年內保險年資合計滿 6 個月以上，並於最近 1 個月內(指開訓日前 1 個月內)有向公立就業服務機構辦理求職登記者。

8. **二度就業婦女**：因家庭因素離開職場兩年以上的婦女。

*須提出相關證明文件影本：如以親屬重大傷病卡或身心障礙證明佐證家庭照顧因素、以戶口名簿證明結婚、生育或親屬年邁等。

9. **家庭暴力被害人**：直轄市、縣(市)政府開立之家庭暴力及性侵害被害人身分證明文件、保護令影本或判決書影本。

10. **更生受保護人**：由財團法人台灣更生保護會或地方法院檢察署觀護人士開立的證明書。

11. **外籍配偶及大陸地區配偶**：台灣地區配偶最近3個月之戶籍謄本(需詳細記事)、有效期間之居留證明文件(正反面)影本。

(三)補助限制

1. 已領取公教人員保險養老給付、勞工保險老年給付、軍人退休俸或公營事業退休金，不得請領。(前項人員符合社會救助法低收入戶或中低收入戶資格、領取中低收入老人生活津貼或身心障礙者生活補助費者，得適用本辦法)
2. 二年內合併領取職業訓練生活津貼(含就業保險法職業訓練生活津貼)及政府機關其他同性質之津貼或補助，最長以 6 個月為限，申請人為身心障礙者，最長以 1 年為限(依據本辦法第 29 條規定)。前項「政府機關其他同性質之津貼或補助」，係指就業保險法所定之職業訓練生活津貼。請領就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼期間，不得同時請領本辦法第 18 條津貼。(2 年內的起算日係以學員該次參訓始日往前推算 2 年。)
3. 領取本辦法職業訓練生活津貼期間，不得同時請領勞工保險條例中所指稱失業給付及職業訓練生活津貼。扣除不得同時請領期間之津貼後，賸餘之職業訓練生活津貼依第 20 條第 2 項規定辦理。
4. 就業促進津貼實施辦法第 2 條第 1 項第 2 款：「本法第 24 條第 1 項各款所列之失業者」其中「失業者」身分應不具有勞工保險被保險人身分。(職業工會、裁減續保與農漁保除外)
5. 參訓學員於參訓期間，如有受僱參加勞工保險且有工作事實者，即認定為提前就業，應依規定辦理退訓，爰職業訓練生活津貼自退訓之日起停止發放。
6. 領取津貼者經原發給津貼單位予以撤銷時，應繳回已領取之津貼；屬不實領取經撤銷者，二年內不得申領本辦法之津貼。
前項經原發給津貼單位書面通知限期繳回，屆期末繳回者，依法移送強制執行。

二、失業青年職前訓練獎勵（學習獎勵金）

1. 獎勵對象：為本國籍失業青年，年滿十五歲至二十九歲，且參加下列訓練課程之一者：

（1）本署及分署自辦、委辦或補助辦理之失業者職前訓練。

（2）產業新尖兵試辦計畫。

年齡之計算，以青年參加訓練課程之開訓日為基準日。

青年依本要點規定領取學習獎勵金，以一次為限。

青年依法領取失業給付或職業訓練生活津貼期間，不得領取本要點之學習獎勵金。

2. 獎勵金：

(1.) 每月發給最高新臺幣八千元；

(2.) 以三十日為一個月計算，一個月以上始發給學習獎勵金；超過三十日之畸零日數，應依下列方式辦理：

✧ 畸零日數期間之訓練時數未達五十小時者，發給半個月。

✧ 畸零日數期間之訓練時數達五十小時者，發給一個月。

3. 補助方式：

(1.) 於開訓後提供銀行存摺封面檔案；

(2.) 待審核通過後，將由分署撥付至學員指定帳戶。

4. 青年有下列情形之一者，分署應不予核發學習獎勵金之全部或一部分；已發給者，經撤銷或廢止原核定處分後，應以書面行政處分限期命其返還：

(1.) 不實申領。

(2.) 以同一事由已領取政府機關其他相同性質之補助或獎助。

(3.) 訓練期間中途離訓或遭訓練單位退訓。

(4.) 訓練期間未到課之時數達全期訓練總時數百分之十以上。

(5.) 規避、妨礙或拒絕分署查對。

(6.) 其他違反本要點之規定。

因不實申領學習獎勵金致撤銷原核定處分者，不得再依本要點發給學習獎勵金。

附件：課程規畫表 - 半導體與AI應用專業人才養成班第05期

- 課程時段：10:00-12:00 13:30-16:30 (部分課程自9:00開始，或至17:30下課)
- 實際課程時間及課程連結將於開訓前通知。

日期	10:00-11:00	11:00-12:00	13:30-14:30	14:30-15:30	15:30-16:30	16:30-17:30	型式
12月12日							
12月13日							
12月14日	開訓	入班宣導	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析		實體
12月15日	基礎數理	基礎數理	基礎數理	基礎數理	基礎數理		
12月16日	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析	
12月17日	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術		
12月18日	就業趨勢與求職技巧	就業趨勢與求職技巧	就業趨勢與求職技巧	就業趨勢與求職技巧	就業趨勢與求職技巧		實體
12月19日							
12月20日							
12月21日	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析	
12月22日	基礎數理	基礎數理	基礎數理	基礎數理	基礎數理		
12月23日	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析		
12月24日	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術		
12月25日							
12月26日							
12月27日							
12月28日	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析		
12月29日	半導體元件與物理	半導體元件與物理	半導體元件與物理	半導體元件與物理	半導體元件與物理		
12月30日	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析		
12月31日	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術		
1月1日							
1月2日							
1月3日							
1月4日	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析	Python與數據分析		
1月5日	半導體元件與物理	半導體元件與物理	半導體元件與物理	半導體元件與物理	半導體元件與物理		
1月6日	矽光子技術導論	矽光子技術導論	矽光子技術導論	矽光子技術導論	矽光子技術導論		
1月7日	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術		
1月8日	AI應用實作	AI應用實作	AI應用實作	AI應用實作	AI應用實作	AI應用實作	實體
1月9日							
1月10日							
1月11日	半導體元件與物理	半導體元件與物理	半導體元件與物理	半導體元件與物理	半導體元件與物理		
1月12日	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術		
1月13日	矽光子技術導論	矽光子技術導論	矽光子技術導論	矽光子技術導論	矽光子技術導論		
1月14日	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術		
1月15日	AI應用實作	AI應用實作	AI應用實作	AI應用實作	AI應用實作	AI應用實作	實體
1月16日							
1月17日							
1月18日	Python與數據分析(專題報告)	Python與數據分析(專題報告)	Python與數據分析(專題報告)	Python與數據分析(專題報告)	Python與數據分析(專題報告)	Python與數據分析(專題報告)	
1月19日	Python與數據分析(專題報告)	Python與數據分析(專題報告)	Python與數據分析(專題報告)	Python與數據分析(專題報告)	Python與數據分析(專題報告)	Python與數據分析(專題報告)	
1月20日	矽光子技術導論	矽光子技術導論	矽光子技術導論	矽光子技術導論	矽光子技術導論		
1月21日	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術	半導體製程技術		
1月22日	光學實驗	光學實驗	光學實驗	光學實驗	光學實驗	光學實驗	實體

1月23日							
1月24日							
1月25日	半導體設備介紹	半導體設備介紹	性別平等課程	性別平等課程	性別平等課程		
1月26日	半導體設備介紹	半導體設備介紹	半導體設備介紹	半導體設備介紹	半導體設備介紹		
1月27日	半導體設備介紹(AOI)	半導體設備介紹(AOI)	半導體設備介紹(AOI)	半導體設備介紹(AOI)	半導體設備介紹(AOI)		
1月28日	光學實驗	光學實驗	光學實驗	光學實驗	光學實驗	光學實驗	實體
1月29日							
1月30日							
1月31日							
2月1日	半導體設備介紹	半導體設備介紹	半導體設備介紹	半導體設備介紹	半導體設備介紹		
2月2日							
2月3日							
2月4日							
2月5日							
2月6日							
2月7日							
2月8日							
2月9日							
2月10日							
2月11日							
2月12日							
2月13日							
2月14日							
2月15日							
2月16日	半導體設備介紹(AOI)	半導體設備介紹(AOI)	半導體設備介紹(AOI)	半導體設備介紹(AOI)	半導體設備介紹(AOI)		
2月17日	半導體封裝概論	半導體封裝概論	半導體封裝概論	半導體封裝概論	半導體封裝概論		
2月18日	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	實體
2月19日	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	實體
2月20日							
2月21日							
2月22日	半導體製程技術(專題報告)	半導體製程技術(專題報告)	半導體製程技術(專題報告)	半導體製程技術(專題報告)	半導體製程技術(專題報告)	半導體製程技術(專題報告)	
2月23日	半導體製程技術(專題報告)	半導體製程技術(專題報告)	半導體製程技術(專題報告)	半導體製程技術(專題報告)	半導體製程技術(專題報告)	半導體製程技術(專題報告)	
2月24日	半導體封裝概論	半導體封裝概論	半導體封裝概論	半導體封裝概論	半導體封裝概論		
2月25日	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA		實體
2月26日	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA		實體
2月27日							
2月28日							
3月1日							
3月2日	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA		實體
3月3日	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	邏輯設計與FPGA	結訓			實體

※訓練單位保留調整課程內容與講師等之權利。